



직무구분	세부직무	우대사항
<p>반도체 공정/소자 설계 (DRAM, Flash, New Memory, Logic, CIS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 메모리 공정개발 및 소자 개발 <ul style="list-style-type: none"> - DRAM/Flash/New Memory 반도체 공정/소자의 특성 예측, 분석 및 개선 - DRAM/Flash/New Memory Process Integration - DRAM/Flash/New Memory 공정/소자 Simulation ■ Logic 공정개발 및 소자 개발 <ul style="list-style-type: none"> - CMOS & Advanced CMOS Device Design (FD SOI, UTB FET, FinFET, NCFET, Nanowire 등) - CMOS Process Integration - Transistor Reliability - Device Circuit Interface - 불량, 특성 개선 통한 수율 예측 및 개선 ■ CIS 공정개발 및 소자 개발 <ul style="list-style-type: none"> - CMOS Image Sensor 픽셀 소자 구조 분석 및 설계 - Pixel 전기적 특성 분석 및 개선 - CIS Process Integration 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 석사 또는 박사 학위 소지자, 박사 학위 취득 예정자(~2021년 2월)
<p>반도체 8대 공정 및 소재 선행개발</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Photo-lithography <ul style="list-style-type: none"> - Lithography Process Engineering - Scanner & Track Engineering - Alignment/Overlay Engineering - Lithography Simulation - DFM(Design for Manufacturability) Engineering - Patterning Resolution Enhancement Technology ■ Dry Etch <ul style="list-style-type: none"> - Dielectric / Conductor Etch 공정 기술 개발 - Dry Etch 공정해석 및 Simulation - Dry Etch 설비 개발 및 모니터링 ■ OPC (Optical Proximity Correction) <ul style="list-style-type: none"> - OPC Engineering & OPC S/W, Lithography Simulator Algorithm 개발 ■ Cleaning <ul style="list-style-type: none"> - Wet Etch & Wafer Surface Cleaning 공정 기술 개발 - 차세대 Wet Chemical 기술 개발 - Single Wet 설비 공정 최적화 & New Physical Cleaning 기술개발 ■ CMP <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 CMP 공정 기술 개발 - Advanced CMP Process Control Module 개발 - Slurry 개발, 유체 Simulation ■ Diffusion/Ion Implantation/Thin Film <ul style="list-style-type: none"> - 박막 (SiN, Poly-S, Oxide, Nitride, High-K 등) 및 박막형성 기술(ALD, CVD, SOG 등) 개발 - High-K ALD 설비 및 공정 개발 - Epitaxy 공정 (Si, SiGe, Ge) 개발 - Ion Implantation, RTP, 열처리 공정 개발 - 유전막, 전극막 공정 및 소재 개발 - 제품 개발 위한 박막 분석/평가 기술 (Impurity, Texturing) ■ FEOL/BEOL Reliability ■ 3D Interconnection <ul style="list-style-type: none"> - 3D Interconnection을 위한 Wafer-to-Wafer bonding 모듈 공정 개발 - Fine Pitch Hybrid Bonding 공정 개발 등 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 석사 또는 박사 학위 소지자, 박사 학위 취득 예정자(~2021년 2월)